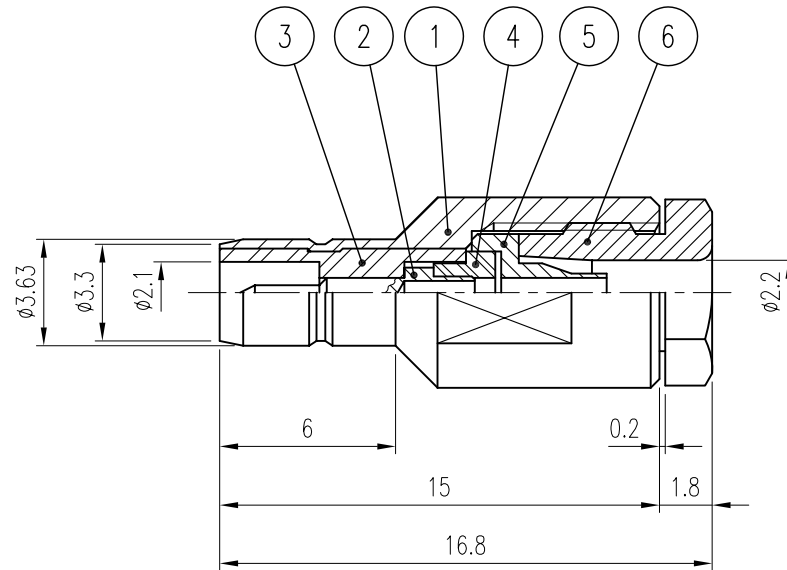


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



6	BACK NUT	1	MBsBD	Gold Plate	DBN00020-135/1 (P3010)
5	INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00023-135/1 (M3007)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00289-N/1 (H3019)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00319-N/1 (H3018)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00382-135/1 (E3015)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00444-135/1 (D3020)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1999. 12. 16.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.				
	승인						
재질	검도			도명	SMB-J3-316		
	재도						
열처리	작성부서		연 구 소		A4	도번	CN00195-7/1
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	총량				K315-254-000